

छत्तीसगढ़ भासन  
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2018

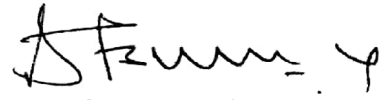
क्रमांक-3-11/2018/56/इसूप्रौः राज्य शासन एतद्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-54/2014/56/इसूप्रौ दिनांक 26/06/2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई योजना) अंतर्गत निम्नालिखित मार्गों के किनारों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राईट ऑफ वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है :-

District Name	Length in Kms.
Balod	256.066
Balrampur	413.000
Bastar	92.745
Bemetara	24.900
Bijapur	251.772
Bilaspur	444.150
Dantewada	167.043
Dhamtari	220.870
Durg	386.300
Gariyaband	123.300
Jagdalpur	40.000
Janjgir-Champa	171.050
Jashpur	205.070
Kabirdham	254.496
Kanker	398.393
Kondagaon	236.960
Korba	209.000
Koriya	231.450
Mahasamund	54.000
Mungeli	56.020
Narayanpur	111.585
Raigarh	223.070
Raipur	577.500
Rajnandgaon	320.412
Sukma	397.230
Surajpur	46.800
Surguja	154.300
<b>Grand Total</b>	<b>6067.48</b>

यह कार्य विभाग की सोसायटी चिप्स द्वारा शासकीय मार्गों पर किया जा रहा है। अतः इस कार्य हेतु सोसायटी को बैंक गारंटी से मुक्त रखा जाता है, परन्तु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व गड्ढों का भराव, सड़क या उनके किनारों की मरम्मत आदि करना होगा। चिप्स में एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी का विमुक्तिकरण, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सड़क, उसके किनारों में टूट-फूट, और खोदे गये गड्ढों का भराव संतोषप्रद रूप से करने के उपरान्त ही किया जाए। यह आदेश छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए वैध है।

चिप्स द्वारा पृथकतः समक्ष अधिकारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, वन मार्गों एवं रेलवे क्रॉसिंग के राईट ऑफ वे के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।

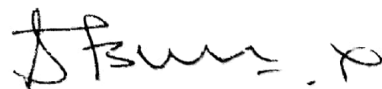
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय शुक्ला) 11/5/18  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी  
विभाग

प्रतिलिपि:

1. संभागीय आयुक्त, (समस्त) -- बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, विलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग।
2. पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय/वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर, (समस्त), छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) छत्तीसगढ़।
7. आयुक्त, नगर पालिका निगम (समस्त) छत्तीसगढ़।
8. वनमंडलाधिकारी, (समस्त) छत्तीसगढ़।
9. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
10. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (समस्त) छत्तीसगढ़।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, विलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, (समस्त) बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, विलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा।
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर (छत्तीसगढ़) -- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(संजय शुक्ला) 11/5/18  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी  
विभाग



**OFFICE OF CHIPS**  
**SDC Building, Civil Lines,**  
**Raipur, CHHATTISGARH**

Phone: 0771-4014158

Fax: 0771-4066205

email: [ceochips@nic.in](mailto:ceochips@nic.in)

No. 737 /CEO/CHIPS/SKY/2018

Raipur Dated: 16 Apr, 2018

To

M/s. Reliance Jio Infocomm Limited  
Maker Chamber 4 9th Floor,  
222 Nariman Point,  
400021 - Mumbai

**Subject: Letter of Award for Selection of Implementation Partner for Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY).**

Reference:

- (i) Tender documents in relation to Notice/Tender No.: THIRDCALL\_02 / CEO / CHIPS / SKY /2018 (including the Request for Proposal ("RFP") dated March 16, 2018) and the draft Agreement ("Agreement"), as available on ([www.chips.gov.in/tenders](http://www.chips.gov.in/tenders)) ("Tender Documents"); and
- (ii) Your bid submission dated 02 April 2018 ("Bid").

Dear Sir/Ma'am,

- **Introduction**

In relation to Tender No. THIRDCALL\_02/CEO/CHIPS/SKY/2018, CHIPS has concluded the bid evaluation process for selection of implementation partner for Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana ("CG-SKY Project"), and is pleased to inform that Reliance Jio Infocomm Limited ("RJIL") is hereby declared the successful bidder. Accordingly, pursuant to the terms of the RFP, this Letter of Award ("LOA") is hereby issued to Reliance Jio Infocomm Limited for implementation of the CG-SKY Project, subject to the conditions as set out in this LOA.

- **Consideration**

For implementation of the CG-SKY Project as envisaged under the Tender Documents (including the RFP and the draft Agreement) in detail and strictly as per the conditions, timelines, technical requirements and standards of performance set out therein, the consideration paid by CHIPS to RJIL shall be in accordance with the Bid submitted by RJIL dated 02 April 2018 ("Consideration"). The Consideration shall be inclusive of all taxes and other levies i.e. excise duty, freight, sales tax, octroi, insurance, customs, service tax, etc. Any revision in the tax shall be payable as per the terms and condition mentioned in the Tender Documents.

- **Acceptance**

In accordance with the terms of the RFP, within 3 (three) business days of the receipt of this LOA, you are requested to sign and return a duplicate copy hereof as its acknowledgement recording on the duplicate copy of the LOA, "Accepted Unconditionally", under the signature of the Authorized Signatory of CHiPS. If the duplicate copy of the LOA duly signed by you is not received by CHiPS within the stipulated date i.e. 19/04/2018, then CHiPS may, unless it consents to extension of time for submission thereof expressly in writing, appropriate the earnest money deposit submitted by RJIL ("EMD") as damages; and in such an event, CHiPS shall be free to consider the next eligible bidder.

- **Other Material Conditions**

RJIL is required to execute the Agreement for the CG-SKY Project with CHiPS within 10 (ten) days from the issuance of this LOA i.e. 26/04/2018; and is further requested to conduct site survey and submit Network Augmentation Plan for Cell-sites as per RFP guidelines within 15 (fifteen) days from date of signing of Agreement i.e. by 01/05/2018, for validation and approval by CHiPS.

RJIL is also directed to submit *performance bank guarantee/PGB 1* for the required amount in the form specified in Clause 4.21 of the RFP, within 7 (seven) business days from the date of notice of this LOA i.e. by 23/04/2018.

This LOA is issued subject to/in anticipation of complete and unconditional compliance by RJIL with all the terms and conditions set out under the Tender Documents as may be required to be fulfilled during the stage between LOA issuance and Agreement execution and thereafter, including submission of the STQC Report in relation to Smartphone I and Smartphone II with the RFP requirements; and the LOA may be revoked or rejected at any time by CHiPS in its sole discretion.

Please acknowledge the receipt of this LOA by return fax/letter, in the manner as aforesaid.



CEO, CHiPS